



2020年3月期 第1四半期決算短信(日本基準)(連結)

2019年7月26日

上場会社名 東京エレクトロン株式会社

上場取引所 東

コード番号 8035 URL <https://www.tel.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 河合 利樹

問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 笹川 謙

TEL 03-5561-7000

四半期報告書提出予定日 2019年8月13日

配当支払開始予定日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2020年3月期第1四半期の連結業績(2019年4月1日～2019年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2020年3月期第1四半期	216,421	26.8	42,552	41.2	44,591	40.7	31,894	42.8
2019年3月期第1四半期	295,569	25.0	72,418	32.2	75,212	36.4	55,741	35.1

(注) 包括利益 2020年3月期第1四半期 27,071百万円 (50.0%) 2019年3月期第1四半期 54,152百万円 (22.9%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2020年3月期第1四半期	195.68	194.72
2019年3月期第1四半期	339.65	338.34

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2020年3月期第1四半期	1,149,391	819,354	70.3
2019年3月期	1,257,627	888,117	70.0

(参考) 自己資本 2020年3月期第1四半期 807,956百万円 2019年3月期 880,748百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2019年3月期		413.00		345.00	758.00
2020年3月期					
2020年3月期(予想)		193.00		309.00	502.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2020年3月期の連結業績予想(2019年4月1日～2020年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	490,000	29.1	85,000	51.5	85,000	53.1	63,000	53.4	388.83
通期	1,100,000	13.9	220,000	29.2	220,000	31.6	164,000	33.9	1,015.21

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

詳細は、「添付資料」9ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有

以外の会計方針の変更 : 無

会計上の見積りの変更 : 無

修正再表示 : 無

詳細は、「添付資料」9ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)」をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)

2020年3月期1Q	165,210,911 株	2019年3月期	165,210,911 株
------------	---------------	----------	---------------

期末自己株式数

2020年3月期1Q	4,151,346 株	2019年3月期	1,252,517 株
------------	-------------	----------	-------------

期中平均株式数(四半期累計)

2020年3月期1Q	162,993,433 株	2019年3月期1Q	164,113,708 株
------------	---------------	------------	---------------

(注) 期末自己株式数には、「役員報酬BIP信託」及び「株式付与ESOP信託」が保有する当社株式(2020年3月期1Q 249,626株、2019年3月期 249,701株)を含めております。また、各信託が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、「添付資料」4ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

・当社は、2019年7月26日に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料につきましては、当社ホームページに掲載する予定です。

【添付資料】

[目次]

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	4
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)	9
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	9
(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)	9
(セグメント情報等)	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間の世界経済につきましては、中国などアジア地域で一部弱さが見られるなど、その伸びは鈍化傾向にあるものの、米国経済は底堅く、また欧州は回復基調を維持し、総じて緩やかな拡大を続けております。

当社グループの参画するエレクトロニクス産業におきましては、データセンター向け設備投資やスマートフォン需要の減速傾向などにより足元では調整局面にあるものの、中長期においてはIoTや人工知能(AI)、次世代通信規格(5G)等を背景とするさらなる市場の拡大が見込まれております。

このような状況のもと、当社グループの当第1四半期連結累計期間の連結業績は、売上高2,164億2千1百万円(前年同期比26.8%減)、営業利益425億5千2百万円(前年同期比41.2%減)、経常利益445億9千1百万円(前年同期比40.7%減)、また、親会社株主に帰属する四半期純利益は318億9千4百万円(前年同期比42.8%減)となりました。

セグメント別の概況は以下のとおりです。

① 半導体製造装置

ロジック系半導体に対する設備投資は新世代向けの投資がおこなわれたものの、データセンター向け需要の減速などを背景にDRAM、3次元構造のNANDフラッシュメモリにおいては、メモリーメーカーで設備投資計画が見直されるなど一時的な調整局面にありますが、今後は需給バランスの改善により、回復基調へ向かうものと見込んでおります。このような状況のもと、当セグメントの当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、1,981億3千7百万円(前年同期比29.3%減)となりました。

② FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置

スマートフォン用中小型有機ELパネル向けの設備投資において投資調整が見られ、テレビ用大型液晶パネル向けの設備投資も減速傾向にありますが、年後半から回復基調に転じるものと見込んでおります。このような状況のもと、当セグメントの当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、182億2千9百万円(前年同期比20.6%増)となりました。

③ その他

当セグメントの当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、5千4百万円(前年同期比0.9%減)となりました。

(ご参考)

【連結業績】

(単位：百万円)

	前期通期				当期第1Q	
	前期第1Q	前期第2Q	前期第3Q	前期第4Q		
売上高	1,278,240	295,569	395,465	268,169	319,036	216,421
半導体製造装置	1,166,781	280,400	358,057	239,525	288,798	198,137
日本	206,035	51,146	58,048	54,095	42,743	32,534
北米	131,931	28,496	45,910	22,767	34,757	28,550
欧州	93,113	17,755	31,345	18,613	25,398	20,270
韓国	305,422	88,986	86,558	60,960	68,917	36,903
台湾	162,922	26,315	48,057	29,384	59,165	48,333
中国	206,914	54,964	71,306	38,099	42,544	27,090
東南アジア他	60,440	12,734	16,830	15,604	15,271	4,454
F P D製造装置	111,261	15,113	37,354	28,598	30,195	18,229
その他	197	55	53	46	42	54
営業利益	310,571	72,418	103,000	58,735	76,416	42,552
経常利益	321,662	75,212	106,034	60,660	79,754	44,591
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	248,228	55,741	79,553	48,831	64,101	31,894

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

(2) 財政状態に関する説明

① 財政状態

当第1四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,115億7千6百万円減少し、8,713億2千万円となりました。主な内容は、有価証券に含まれる短期投資の減少940億円、受取手形及び売掛金の減少506億1千2百万円、現金及び預金の増加422億5千1百万円によるものであります。

有形固定資産は、前連結会計年度末から18億7千7百万円増加し、1,519億4千6百万円となりました。

無形固定資産は、前連結会計年度末から2億3百万円減少し、88億5千1百万円となりました。

投資その他の資産は、前連結会計年度末から16億6千5百万円増加し、1,172億7千3百万円となりました。

これらの結果、総資産は、前連結会計年度末から1,082億3千6百万円減少し、1兆1,493億9千1百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ396億4千1百万円減少し、2,652億4千万円となりました。主として、未払法人税等の減少409億6千3百万円、賞与引当金の減少241億5千3百万円、前受金の増加274億8千万円によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ1億6千7百万円増加し、647億9千5百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ687億6千2百万円減少し、8,193億5千4百万円となりました。主として、親会社株主に帰属する四半期純利益318億9千4百万円を計上したことによる増加、前期の期末配当566億5千1百万円の実施による減少、自己株式の取得432億5千3百万円による減少によるものであります。この結果、自己資本比率は70.3%となりました。

② キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の当第1四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ232億5千1百万円増加し、2,558億8千6百万円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資850億円を加えた残高は、前連結会計年度末に比べ517億4千8百万円減少し、3,408億8千6百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、前年同期に比べ79億9千6百万円増加の594億6千6百万円の収入となりました。主な要因につきましては、売上債権の減少487億6千2百万円、税金等調整前四半期純利益445億7千2百万円、未収消費税等の減少354億5千1百万円、前受金の増加277億4千6百万円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、法人税等の支払額520億6千4百万円、たな卸資産の増加295億3千4百万円、賞与引当金の減少239億6千1百万円がそれぞれキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主として定期預金及び短期投資の減少による収入750億円、有形固定資産の取得による支出80億8千8百万円により、前年同期の211億5千3百万円の支出に対し664億5千2百万円の収入となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に配当金の支払566億5千1百万円、自己株式の取得による支出432億5千3百万円により、前年同期の569億4千8百万円の支出に対し999億9千4百万円の支出となりました。

【連結キャッシュ・フロー(要約)】

(単位：百万円)

	前第1四半期 連結累計期間	当第1四半期 連結累計期間
営業活動によるキャッシュ・フロー	51,470	59,466
税金等調整前四半期純利益	75,205	44,572
減価償却費	5,078	6,081
売上債権の増減額(△は増加)	8,403	48,762
たな卸資産の増減額(△は増加)	△37,454	△29,534
仕入債務の増減額(△は減少)	△7,929	945
その他	8,166	△11,360
投資活動によるキャッシュ・フロー	△21,153	66,452
定期預金及び短期投資の増減額(△は増加)	△9,000	75,000
その他(固定資産の取得等)	△12,153	△8,547
財務活動によるキャッシュ・フロー	△56,948	△99,994
自己株式の取得	△0	△43,253
その他(配当金の支払等)	△56,948	△56,740
現金及び現金同等物に係る換算差額	△657	△2,673
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△27,289	23,251
現金及び現金同等物の期首残高	257,877	232,634
現金及び現金同等物の四半期末残高	230,588	255,886
現金及び現金同等物並びに満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資の四半期末残高	355,588	340,886

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2020年3月期の連結業績予想につきましては、前回発表時(2019年4月26日)の見通しを変えておりません。

※この決算短信に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否、並びに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	177,634	219,886
受取手形及び売掛金	146,971	96,358
有価証券	215,000	121,000
商品及び製品	234,102	256,718
仕掛品	62,785	71,975
原材料及び貯蔵品	57,331	52,371
その他	89,156	53,123
貸倒引当金	△84	△112
流動資産合計	982,897	871,320
固定資産		
有形固定資産	150,069	151,946
無形固定資産		
その他	9,054	8,851
無形固定資産合計	9,054	8,851
投資その他の資産		
その他	117,033	118,688
貸倒引当金	△1,426	△1,415
投資その他の資産合計	115,607	117,273
固定資産合計	274,730	278,070
資産合計	1,257,627	1,149,391

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	75,448	75,058
未払法人税等	57,671	16,707
前受金	77,247	104,728
製品保証引当金	14,097	12,431
その他の引当金	38,251	9,463
その他	42,166	46,850
流動負債合計	304,882	265,240
固定負債		
その他の引当金	932	119
退職給付に係る負債	60,600	60,503
その他	3,094	4,172
固定負債合計	64,628	64,795
負債合計	369,510	330,036
純資産の部		
株主資本		
資本金	54,961	54,961
資本剰余金	78,011	78,011
利益剰余金	748,827	724,075
自己株式	△11,821	△55,039
株主資本合計	869,977	802,008
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	13,024	13,772
繰延ヘッジ損益	△34	77
為替換算調整勘定	4,366	△2,041
退職給付に係る調整累計額	△6,585	△5,860
その他の包括利益累計額合計	10,770	5,947
新株予約権	7,368	11,398
純資産合計	888,117	819,354
負債純資産合計	1,257,627	1,149,391

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
売上高	295,569	216,421
売上原価	173,085	126,537
売上総利益	122,483	89,884
販売費及び一般管理費		
研究開発費	26,131	25,692
その他	23,933	21,639
販売費及び一般管理費合計	50,065	47,332
営業利益	72,418	42,552
営業外収益		
受取配当金	346	434
為替差益	1,891	1,043
その他	589	623
営業外収益合計	2,826	2,101
営業外費用		
閉鎖拠点維持管理費用	12	—
その他	19	62
営業外費用合計	32	62
経常利益	75,212	44,591
特別利益		
固定資産売却益	0	0
特別利益合計	0	0
特別損失		
固定資産除売却損	7	19
特別損失合計	7	19
税金等調整前四半期純利益	75,205	44,572
法人税等	19,463	12,677
四半期純利益	55,741	31,894
親会社株主に帰属する四半期純利益	55,741	31,894

四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
四半期純利益	55,741	31,894
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△2,008	749
繰延ヘッジ損益	△347	98
為替換算調整勘定	243	△6,381
退職給付に係る調整額	519	715
持分法適用会社に対する持分相当額	2	△4
その他の包括利益合計	△1,589	△4,822
四半期包括利益	54,152	27,071
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	54,152	27,071

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当社は、2019年5月27日開催の取締役会決議に基づき、自己株式の取得を行いました。この取得等により自己株式は、当第1四半期連結累計期間において43,217百万円増加し、当第1四半期連結会計期間末において55,039百万円となりました。

(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

税金費用の計算

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)

会計方針の変更

(IFRS第16号「リース」の適用)

当第1四半期連結会計期間より、一部の在外連結子会社は、IFRS第16号「リース」を適用し、原則としてすべての借手としてのリースを貸借対照表に資産及び負債として計上しております。当該会計基準の適用が四半期連結財務諸表に及ぼす影響は、軽微であります。

(セグメント情報等)

① 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、BU(ビジネスユニット)を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「半導体製造装置」及び「FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置」を報告セグメントとしております。

「半導体製造装置」の製品は、ウェーハ処理工程で使われるコータ/デベロッパ、エッチング装置、成膜装置、洗浄装置、ウェーハ検査工程で使われるウェーハプローバ及びその他半導体製造装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「FPD製造装置」の製品は、フラットパネルディスプレイ製造用のコータ/デベロッパ、エッチング/アッシング装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)

(単位:百万円)

	報告セグメント		その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 3
	半導体 製造装置	FPD 製造装置				
売上高	198,137	18,229	4,436	220,803	△4,381	216,421
セグメント利益	46,483	3,500	235	50,218	△5,646	44,572

- (注) 1. 「その他」は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループの物流・施設管理・保険業務等であります。
2. セグメント利益の調整額△5,646百万円は、報告セグメントに帰属しない当社における基礎研究又は要素研究等の研究開発費△4,751百万円、及びその他の一般管理費等であります。
3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と調整を行っております。

③ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。